

***winbond***



**2018 Q4 法說會**

**Jan 31, 2019**



# 免責聲明

- We have made forward-looking statements in this presentation. Our forward-looking statements contain information regarding, among other things, our financial condition, future expansion plans and business strategies. We have based these forward-looking statements on our current expectations and projections about future events. Although we believe that these expectations and projections are reasonable, such forward-looking statements are inherently subject to risks, uncertainties and assumptions about us.
- We undertake no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements whether as a result of new information, future events or otherwise. In light of these risks, uncertainties and assumptions, the forward-looking events discussed in this conference might not occur and our actual results could differ materially from those anticipated in these forward-looking statements.
- The information contained herein shall also not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the company's securities nor shall there be any sale of such securities in any state or country in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or country.

***winbond***



# 財務報告



## 綜合損益表- 合併

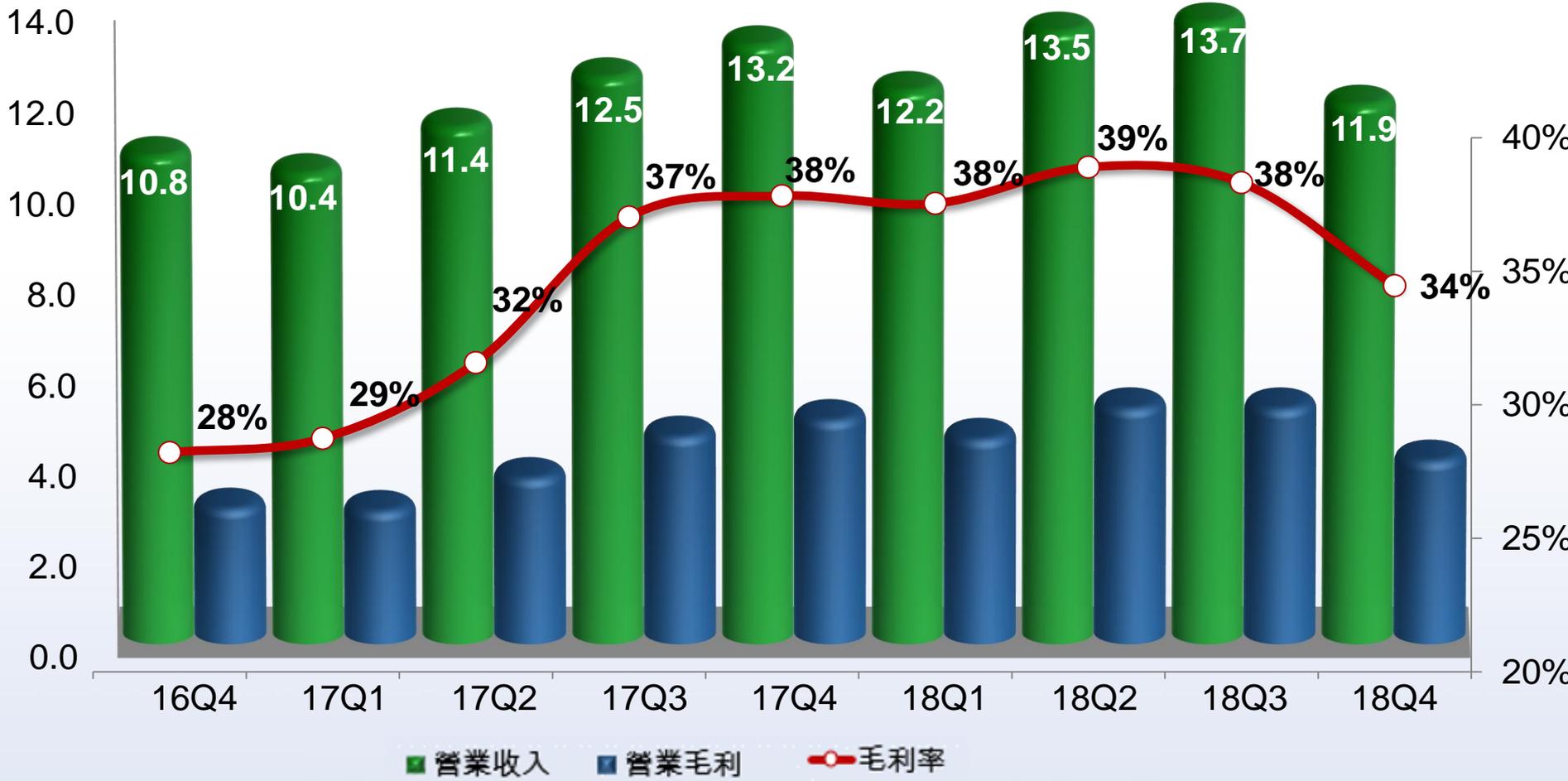
單位: 新台幣百萬元	2018Q4	2018Q3	QoQ	2018	2017	YoY
營業收入	11,868	13,681	(1,812)	51,190	47,592	3,598
營業毛利	4,072	5,250	(1,178)	19,151	16,324	2,827
營業毛利率	34%	38%		37%	34%	
營業利益	1,229	2,212	(984)	7,927	6,656	1,271
營業利益率	10%	16%		15%	14%	
營業外收入及支出	(44)	206	(250)	468	442	26
所得稅(費用)利益	(245)	498	(743)	(667)	(1,275)	608
本期淨利	940	2,917	(1,977)	7,728	5,823	1,905
每股(損)益	0.22	0.71	(0.49)	1.87	1.54	0.33
息前稅前折舊與攤銷前利益	3,245	4,186	(941)	15,510	12,740	2,770



# 營收與毛利- 合併

營收 (新台幣十億元)

毛利率





## 資產負債表- 合併

單位: 新台幣百萬元	Dec. 31 '18	%	Sep. 30 '18	%	Dec. 31 '17	%
現金及約當現金	12,560	13%	16,571	17%	14,172	16%
存貨	10,908	11%	9,906	10%	8,140	9%
不動產, 廠房及設備	52,484	55%	49,131	50%	43,829	50%
<b>資產總計</b>	<b>96,042</b>	<b>100%</b>	<b>98,760</b>	<b>100%</b>	<b>88,116</b>	<b>100%</b>
長期負債	14,099	14%	16,694	17%	8,729	10%
<b>負債總計</b>	<b>32,151</b>	<b>33%</b>	<b>33,595</b>	<b>34%</b>	<b>26,489</b>	<b>30%</b>
<b>股東權益</b>	<b>63,891</b>	<b>67%</b>	<b>65,165</b>	<b>66%</b>	<b>61,627</b>	<b>70%</b>
負債/權益比	0.50		0.52		0.43	
流動比率	2.28		2.77		2.29	



## 現金流量表- 合併

單位: 新台幣百萬元	2018Q4	2018Q3	QoQ	2018	2017	YoY
營運活動現金流量	3,145	3,178	(33)	13,533	12,143	1,390
折舊與攤銷	2,016	1,974	42	7,583	6,084	1,499
投資活動現金流量	(5,215)	(1,682)	(3,533)	(17,062)	(15,030)	(2,032)
資本支出	(5,135)	(1,656)	(3,479)	(16,930)	(15,412)	(1,518)
籌資活動現金流量	(1,959)	5,728	(7,687)	1,854	9,458	(7,604)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(4,011)	7,226	(11,237)	(1,613)	6,489	(8,102)
期末現金及約當現金	12,560	16,571	(4,011)	12,560	14,172	(1,612)



# 2018 財務摘要- 合併

單位:新台幣百萬	2018	2017	YoY
營業收入	51,190	47,592	+8%
毛利率	37%	34%	+ 3 pts.
營業利益率	15%	14%	+ 1 pts.
本期淨利	7,728	5,823	+33%
息前稅前折舊與攤銷前利益	15,510	12,740	+22%
每股盈餘(NT\$)	1.87	1.54	+21%
營運活動現金流量	13,533	12,143	+12%
資本支出	16,930	15,412	+10%
現金與約當現金	12,560	14,172	-11%
股東權益報酬率	12%	9%	+ 3 pts.

- ❖ 營收達NT\$511.9億，YoY成長8%，達18年新高紀錄
- ❖ 毛利率增加為37%，主要受惠於平均銷售價格增加及市場需求成長
- ❖ 持續投入資本支出以擴充產能及製程技術轉換
- ❖ EPS 為NT\$1.87，較2017年成長21%
- ❖ 已連續6年保持獲利



## 綜合損益表- 記憶體

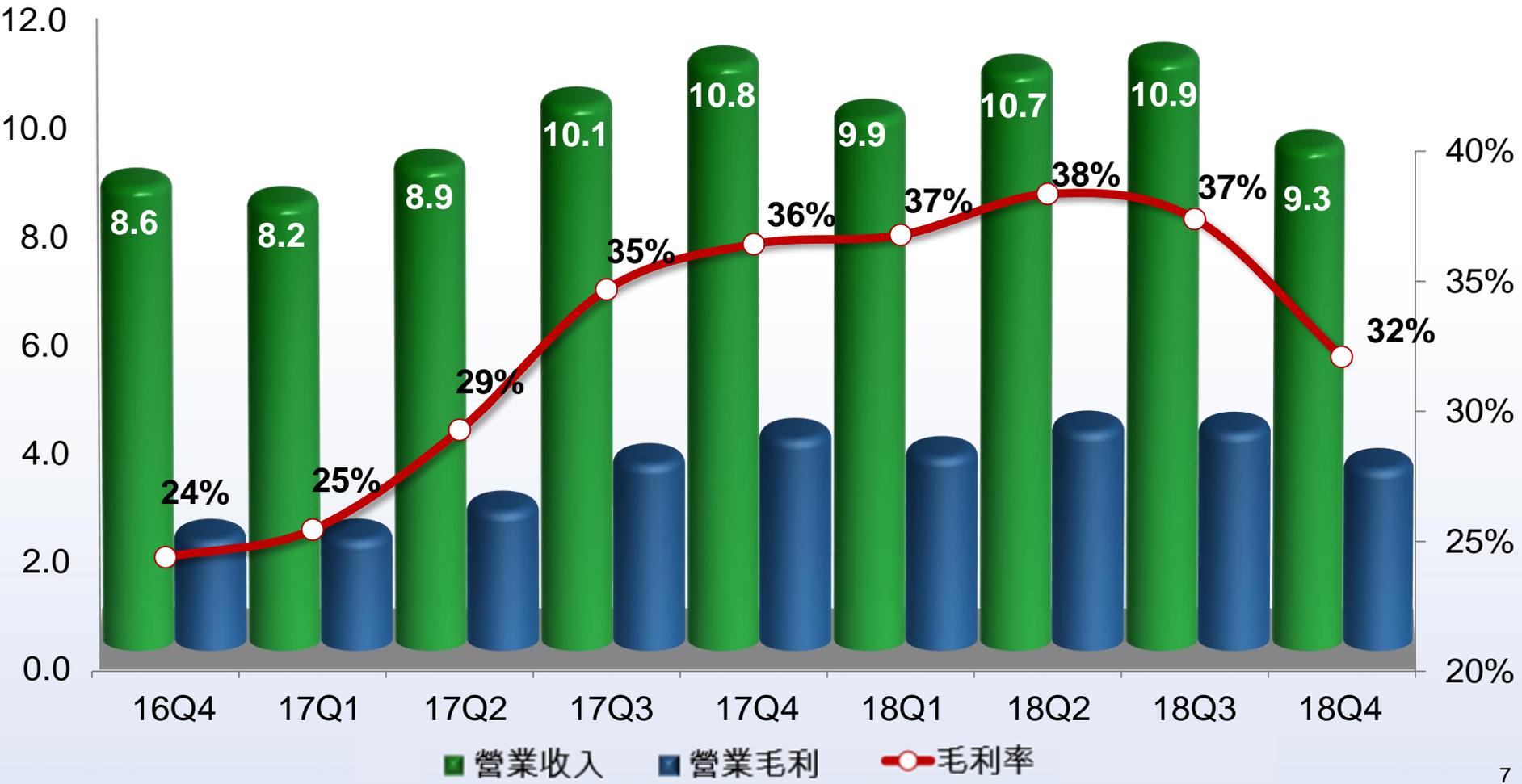
單位: 新台幣百萬元	2018Q4	2018Q3	QoQ	2018	2017	YoY
營業收入	9,293	10,903	(1,610)	40,734	38,103	2,631
營業毛利	2,982	4,077	(1,095)	14,781	12,158	2,623
營業毛利率	32%	37%		36%	32%	
營業利益	967	1,932	(965)	6,944	5,711	1,233
營業利益率	10%	18%		17%	15%	
營業外收入及支出	108	362	(254)	993	942	51
所得稅(費用)利益	(196)	546	(742)	(491)	(1,102)	611
本期淨利	879	2,840	(1,961)	7,446	5,551	1,895
每股(損)益	0.22	0.71	(0.49)	1.87	1.54	0.33
息前稅前折舊與攤銷前利益	2,914	3,836	(922)	14,254	11,532	2,722



# 營收與毛利- 記憶體

營收(新台幣十億元)

毛利率





## 資產負債表- 記憶體

單位: 新台幣百萬元	Dec. 31 '18	%	Sep. 30 '18	%	Dec. 31 '17	%
現金及約當現金	9,385	10%	13,898	15%	11,658	14%
存貨	9,331	10%	8,327	9%	6,497	8%
不動產, 廠房及設備	51,578	56%	48,220	51%	42,969	51%
<b>資產總計</b>	<b>92,173</b>	<b>100%</b>	<b>95,000</b>	<b>100%</b>	<b>84,410</b>	<b>100%</b>
長期負債	14,099	15%	16,694	18%	8,729	10%
<b>負債總計</b>	<b>29,729</b>	<b>32%</b>	<b>31,258</b>	<b>33%</b>	<b>24,198</b>	<b>29%</b>
<b>股東權益</b>	<b>62,444</b>	<b>68%</b>	<b>63,742</b>	<b>67%</b>	<b>60,212</b>	<b>71%</b>
負債/權益比	0.48		0.49		0.40	
流動比率	2.13		2.67		2.16	



## 現金流量表- 記憶體

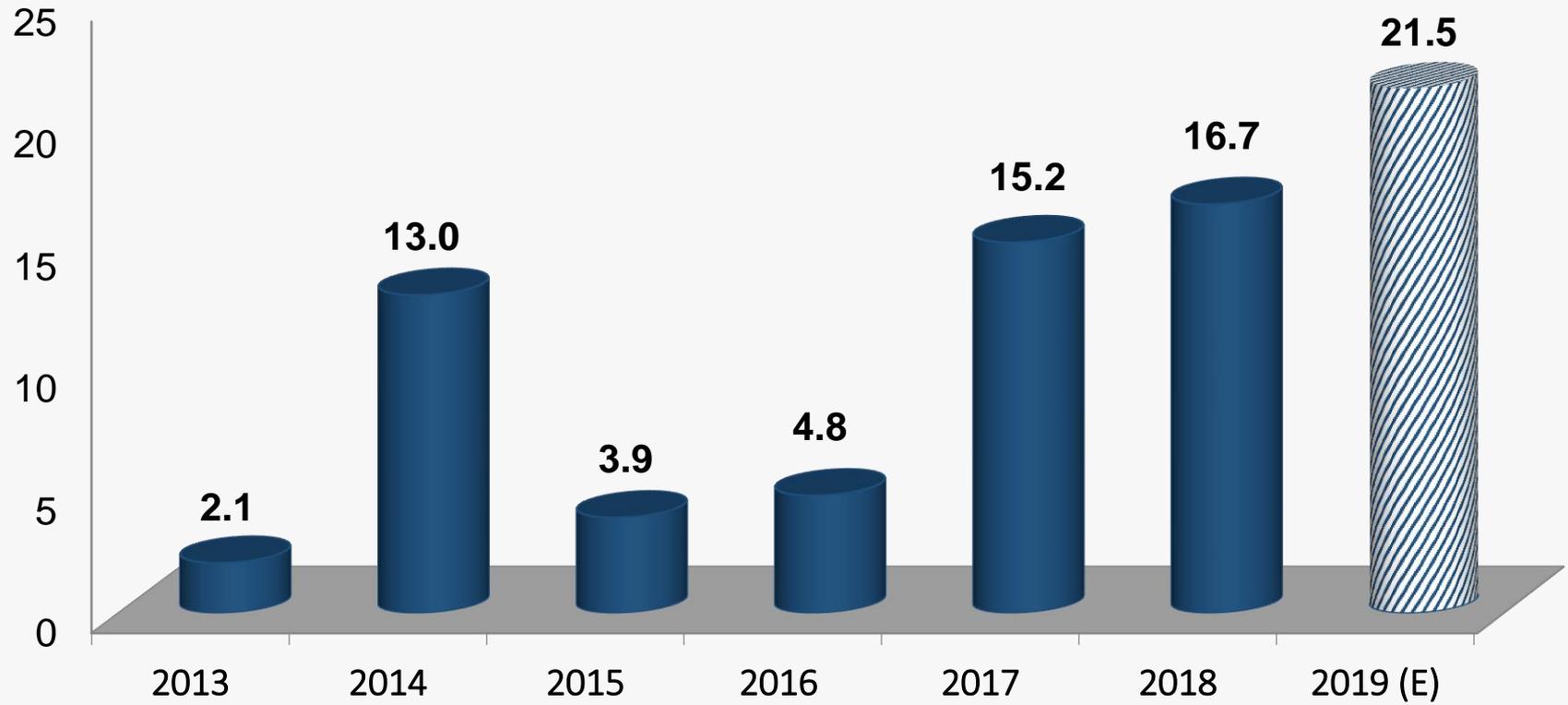
單位: 新台幣百萬元	2018Q4	2018Q3	QoQ	2018	2017	YoY
營運活動現金流量	2,589	3,260	(671)	12,839	11,879	960
折舊與攤銷	1,947	1,904	43	7,310	5,821	1,489
投資活動現金流量	(5,140)	(2,042)	(3,098)	(17,170)	(14,598)	(2,572)
資本支出	(5,070)	(1,609)	(3,461)	(16,714)	(15,108)	(1,606)
籌資活動現金流量	(1,962)	5,934	(7,896)	2,057	9,503	(7,446)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(4,513)	7,152	(11,665)	(2,274)	6,784	(9,058)
期末現金及約當現金	9,385	13,898	(4,513)	9,385	11,658	(2,273)



# 2018年 及 2019年資本支出

(新台幣十億元)

現金基礎資本支出- 截至12/31/2018



***winbond***

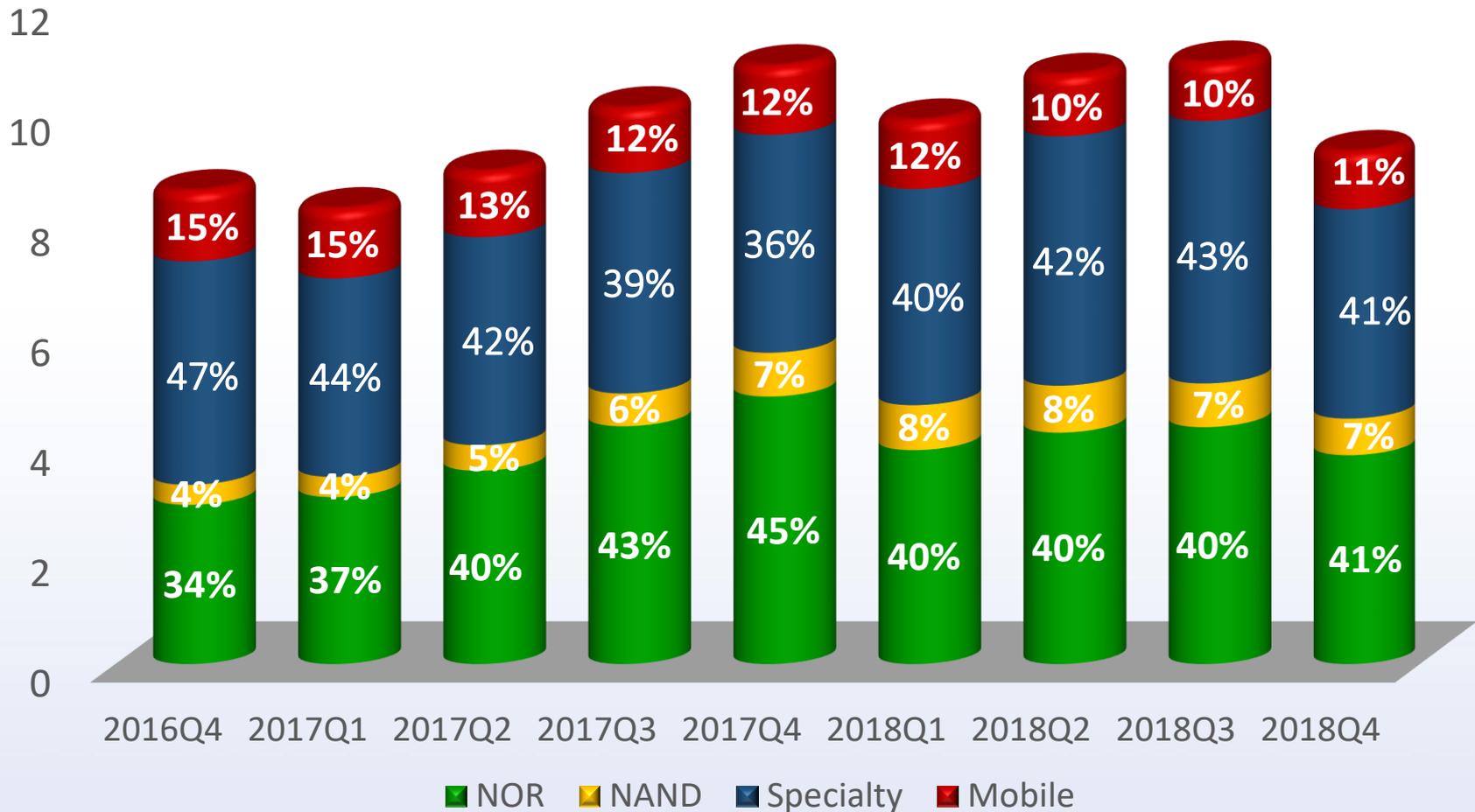


## 營運回顧與展望



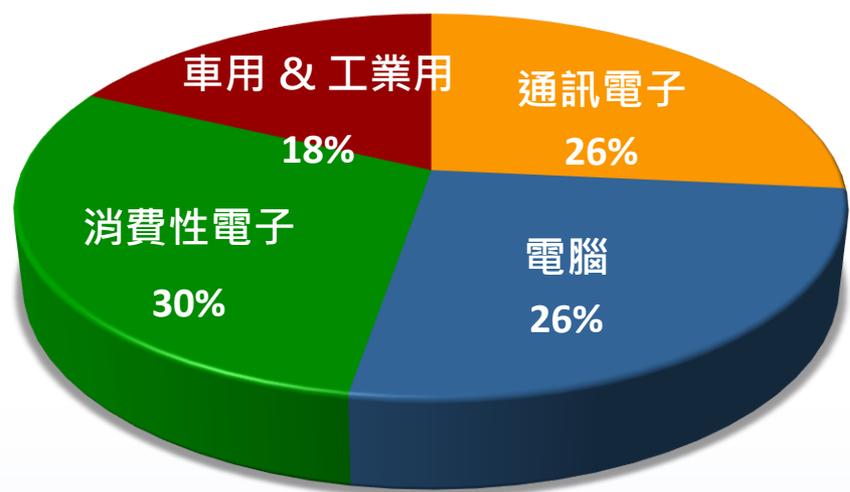
# 4Q18 記憶體營收分析

營收(新台幣十億元)



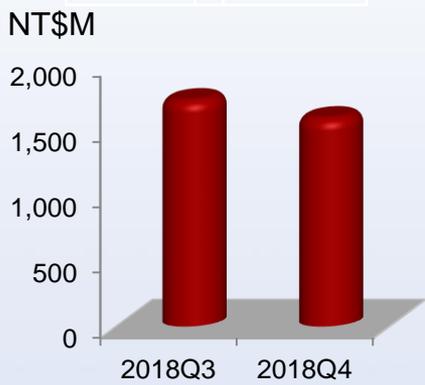


# 4Q18 記憶體營收分析- 依應用面



註: 不含晶圓代工及其他

**車用 & 工業用**  
QoQ - 8%



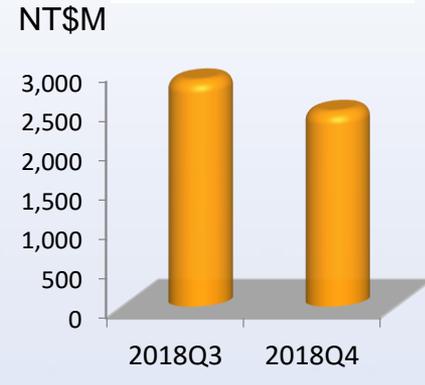
**消費性電子**  
QoQ - 14%



**電腦**  
QoQ - 12%

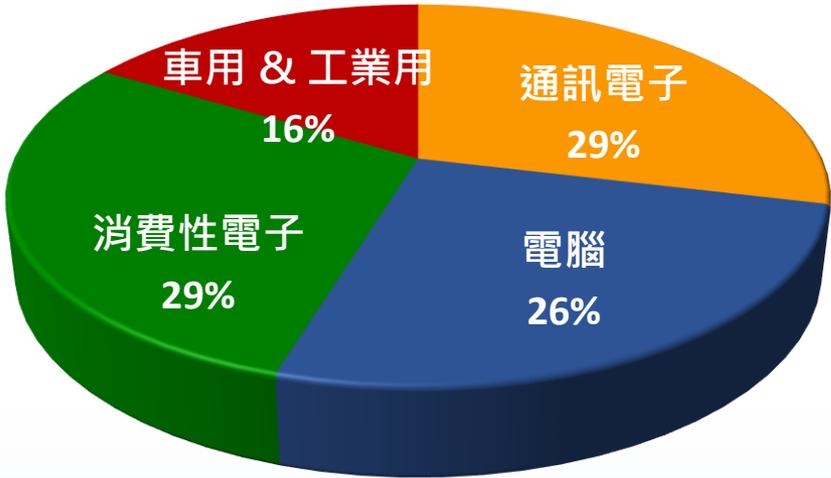


**通訊電子**  
QoQ - 14%





# 2018記憶體營收分析- 依應用面



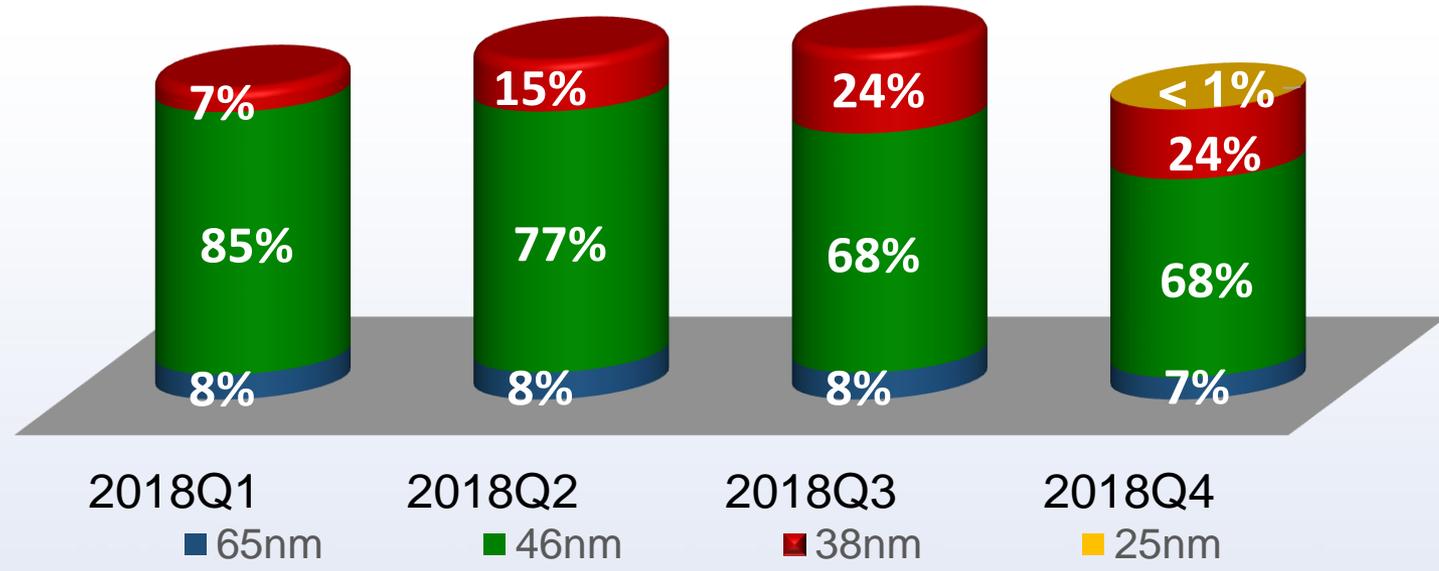
註: 不含晶圓代工及其他





# DRAM

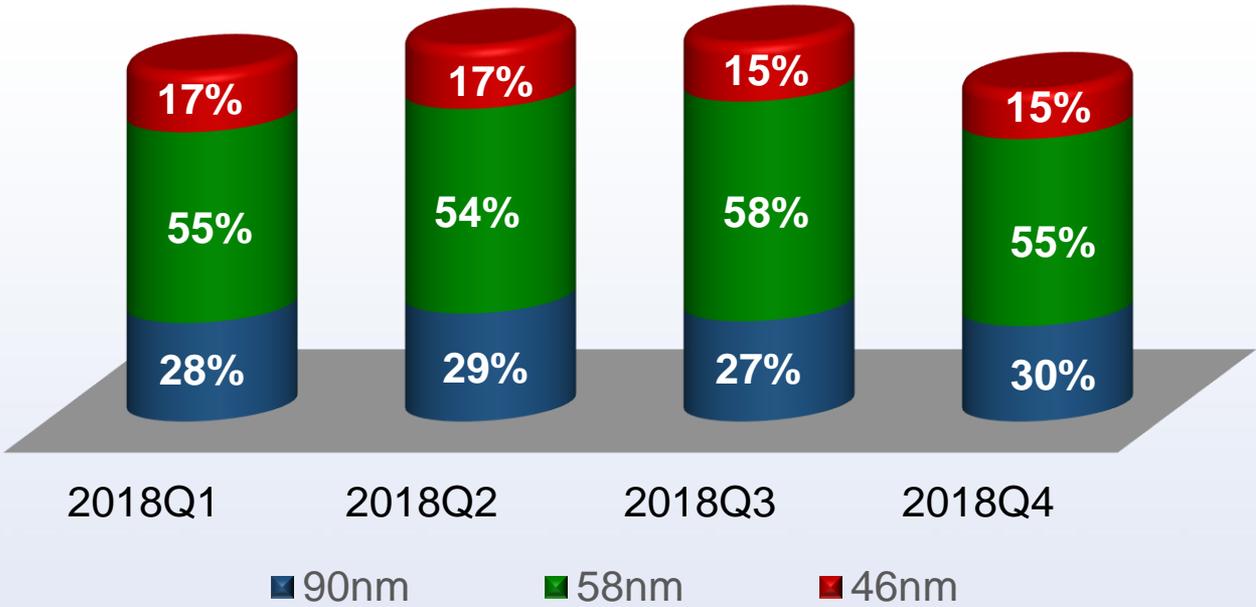
- ❑ 營收季對季減少17% ; 銷售量減少低十位數百分比 ; 平均銷售單價減少低個位數百分比
- ❑ 2018年第四季開始小幅量產25nm 2G DDR3





# Flash

- 營收季對季減少12%；銷售量減少高個位數百分比；平均銷售單價減少低個位數百分比
- 與NOR相比，NAND受到較大的價格競爭壓力





## 2018 年重點營運成果

- ❖ 成功發行NT\$100億元國內有擔保普通公司債
- ❖ 華邦十二吋晶圓高雄廠正式動土興建
- ❖ 1.2V Serial NOR Flash 獲得「2018全球電子成就獎- 年度創新產品獎」
- ❖ 開始正式量產25nm產品



# 市場近況及展望

2017 ~ 2018/1H

2018/2H

2019

## 市場

- ❖ 各式應用需求興起，帶動市場榮景
- ❖ 客戶及通路商重複下單 & 提前拉貨效應

## 供給端

- ❖ 因應市場強勁的需求而增加產出及產能

## 市場

- ❖ 中美貿易戰開打
- ❖ EMS供應鏈廠商因應中美貿易戰而進行生產基地移轉
- ❖ 產生存貨調整
- ❖ 導致整體需求旺季不旺

## 供給端

- ❖ 廠商普遍資本支出保守以減緩產能擴張速度

## 市場

- ❖ 智慧手機和比特幣的需求持續走弱
- ❖ 來自終端客戶的需求整體來說仍正常
- ❖ 通路的存貨調整預期在2019上半年可望恢復至正常水準

## 供給端

- ❖ 供應鏈需要時間消化廠商之前於景氣好時所規劃的新增產能



# 華邦營運及展望

## ❖ 營運

- 整體訂單需求，和來自重要客戶的下單佔比相對穩固

## ❖ 產品

- 推出 2Gb/4Gb DDR3 和 2Gb LP DDR4
- 加強應用於PC BIOS、伺服器、和車用方面之256Mb 及 512Mb Serial NOR Flash產品推展
- 車用和Serial SLC NAND: 增加與客戶的新產品開發案
- Security Flash 和1.2伏 SPI Flash 兩類產擁有品許多未來的潛在市場

## ❖ 研發與技術

- 25 nm微縮版DRAM研發: 按進度進行
- 2x nm SLC NAND: 進行開發中
- 4x nm NOR : 進行開發中

## ❖ 高雄廠

- 動土及興建計畫依時程順利進行中
- DRAM製程及產品研發亦按計畫進行中

***winbond***



**2018 Q4 Investor Conference**

**謝謝**

**Jan 31, 2019**